

(立地協定締結式について)

企業立地課

直 通：092-643-3441

内 線：3758

担 当：中森、菊本

(糸島リサーチパークについて)

企業局管理課

直 通：092-643-3786

内 線：4972

担 当：山田、寺尾

リンテック株式会社の新研究施設 「半導体ソリューションラボ」の開設が決まりました！ ～8月21日、県庁で立地協定締結式を行います～

福岡県では、新たな雇用の創出や関連企業との取引拡大等による地域経済の活性化を目的に、企業立地を推進しています。

このたび、粘着素材・粘着関連機器・半導体関連材料などの開発・製造・販売を行う「リンテック株式会社」が、半導体・電子部品製造工程用材料などの開発のため、本県の「糸島リサーチパーク」に、新たな研究施設「半導体ソリューションラボ」を開設します。

今回の立地は、生成AIの普及等を背景とした半導体需要の拡大や、半導体デバイスの三次元実装・チップレット集積などの技術革新に対応するため、同社が進めるパッケージング技術に関わるテープ・装置及びプロセスの開発を一層発展させるものであり、本県が目指す新生シリコンアイランド九州の実現に寄与することが期待されます。

開設に先立ち、同社との立地協定締結式を下記のとおり実施します。

1 概 要

立 地 場 所	糸島リサーチパーク（糸島市東）
面 積	敷地面積 約3,435㎡
投資予定額	約200億円
従 業 員 数	25人程度（開設時は15人程度）を予定（新規雇用予定者数は未定）
竣 工 予 定	2028年（令和10年）10月
業 務 内 容	半導体・電子部品製造工程用材料などの開発

2 立地協定締結式

- ・ 日 時 : 令和8年8月21日（金） 13時30分～14時00分
- ・ 場 所 : 福岡県庁8階 特別会議室
- ・ 出席者（署名者）：リンテック株式会社 代表取締役社長 はっとり まこと 服部 真
福岡県知事 服部 誠太郎
糸島市長 月形 祐二
- ・ 次 第 : 立地協定締結、歓迎の挨拶（服部知事、月形市長）、進出企業の挨拶（服部社長）

※立地協定締結式終了後、同室で、代表取締役社長の服部様が取材に応じます。

3 企業概要

社 名	リンテック株式会社
代 表 者	代表取締役社長 服部 真
本社所在地	東京都板橋区本町23番23号
設 立	1934年（昭和9年）10月
資 本 金	233億5,500万円（2026年3月31日現在）
売 上 高	連結：3,193億8,500万円 単体：1,810億4,800万円（いずれも2026年3月期）
従 業 員 数	連結：5,237人 単体：2,673人（いずれも2026年3月31日現在）
業 務 内 容	粘着素材、粘着関連機器、特殊紙、剥離（はくり）紙・ 剥離フィルムなどの開発・製造・販売

4 糸島リサーチパーク概要

糸島リサーチパークは西九州自動車道の前原インターチェンジに隣接する団地であり、福岡市の中心部からのアクセスに優れています。次世代半導体の重要技術である「三次元実装」及び「チップレット集積」分野で設計・試作から評価・解析及び実証までを一貫して支援する国内唯一の公的機関である「福岡超集積半導体ソリューションセンター」のほか、九州大学の研究成果等を利用した研究・開発等を行う研究機関や工場が集積しています（別紙参照）。

なお、今回の立地により、糸島リサーチパークは完売となりました。



本件に関する詳細について、本日（8月4日）、リンテック株式会社よりプレスリリースをリンテック株式会社ホームページ（<https://www.lintec.co.jp/>）へ掲載いたします。

問い合わせ先：リンテック株式会社 広報・IR室（03-5248-7741）



企業HP

糸島リサーチパークの集積状況

企業名/施設名	立地時期	主な業務内容
[今回立地] リンテック株式会社	令和8年8月	半導体・電子部品製造工程用材料などの開発
昭栄化学工業株式会社	令和4年4月	次世代ディスプレイ向け量子ドットの生産及び研究開発
株式会社熊本精研工業	平成31年3月	精密金型部品、精密装置部品などの製造
株式会社 Braveridge	平成29年4月	I o T向け製品の開発・生産
福岡超集積半導体 ソリューションセンター (旧 三次元半導体研究センター 及び社会システム実証センター)	令和7年8月 (平成23年3月)	次世代半導体の重要技術である「三次元実装」及び「チップレット集積」分野で設計・試作から評価・解析及び実証までを一貫して支援 (令和7年8月に両センターを福岡超集積半導体ソリューションセンターへ統合)
水素エネルギー製品 研究試験センター	平成22年4月	試作品等の製品試験、水素関連製品の開発、試験方法の研究開発など

